

## 日本芝浦电子 NTC热敏电阻元件 RB1系列热敏电阻 (Shibaura Thermistors NTC thermistors RB1 Thermistor)

采购热线：021-62041958, 021-62041956

E-Mail电子邮箱：tpqe@tpqe.com



微信扫一扫左侧二维码，  
手机/平板浏览本产品信息

### 功能特点

芝浦热敏电阻元件：

由于采用玻璃封装、与树脂封装热敏电阻相比、具有出色的耐热和耐候条件性能、使用寿命更长。

由于通过金电极将导线结合到热敏电阻芯片、特性稳定（PSB-S、NS、PL形热敏电阻元件）。

由于采用致密的精细陶瓷热敏电阻芯片、保持稳定特性。

由于可缩小尺寸、热响应性出色。

由于一贯性自动化生产方式制造、大量提供品质均一的制品。

处理选项

芝浦电子由于卓越的FA(工厂自动化)技术，自己公司内设计几乎全自动生产设备。

关于导线金属镀层和接料带、请与我们联系咨询。

RB1系列N形热敏电阻

电阻值容差和B值容差±1%的高精度

由于再检讨材料及制造条件，将电阻值和B值规格高精度化的热敏电阻。

关于最高工作温度，比标准的PSB形热敏电阻较低，但是玻璃封装热敏电阻的基本结构没变，比一般的树脂热敏电阻，性及加工热历程的优越性。

特点

热敏电阻芯片上采用银钯合金(AgPd)电极

耐热温度是120℃，重视性价比

电阻值容差及B值容差±1%的专用设计

由于玻璃封装，确保耐候性

采用一贯性自动化生产，可以批量生产供应高品质品

用途例

在高温域不使用的各种用途

工作温度范围 -50 ~ +120℃

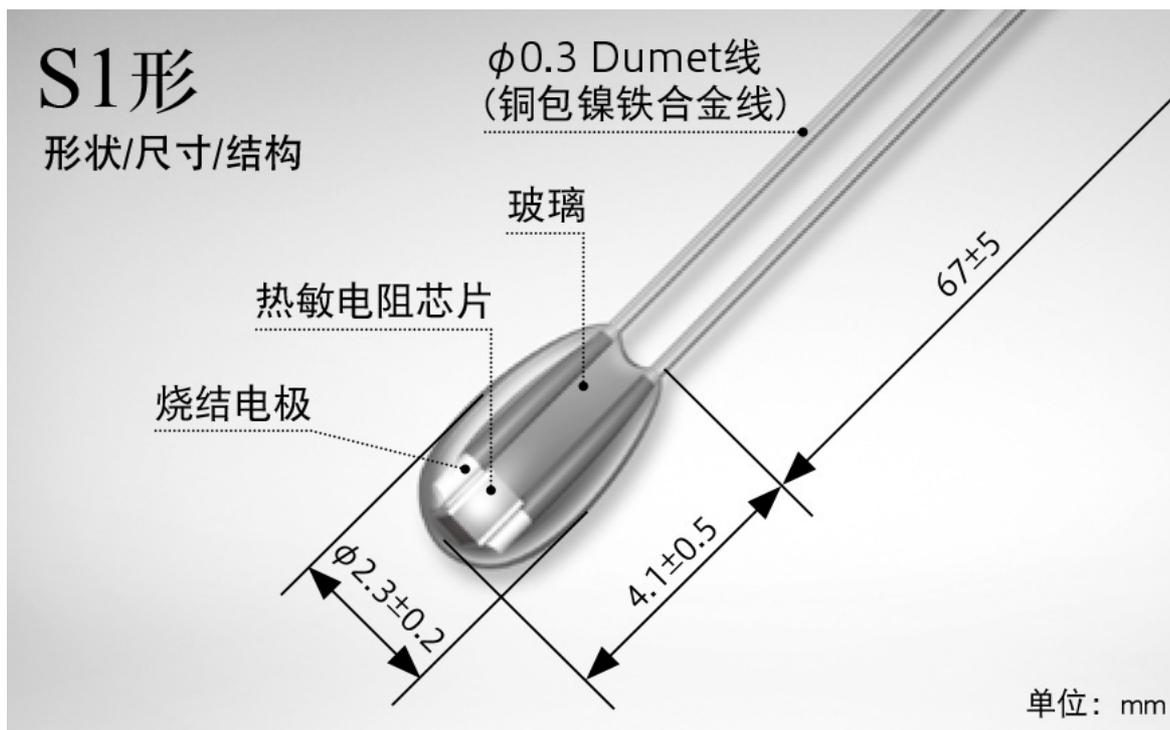
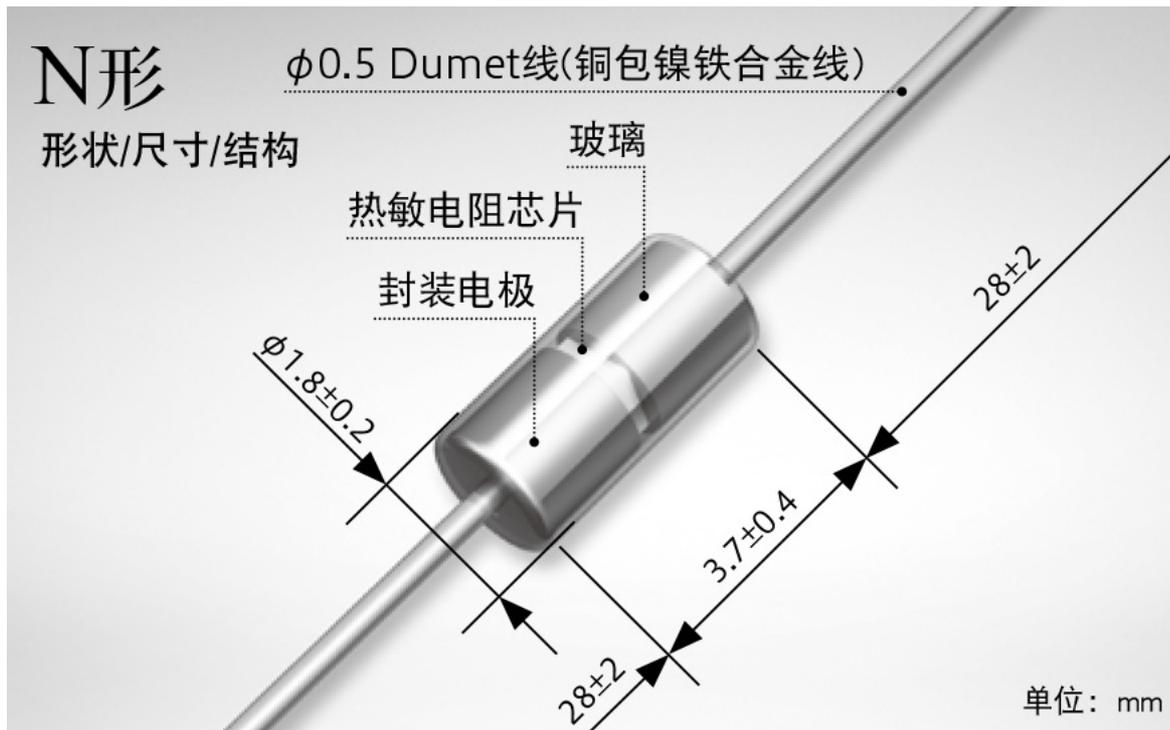
热时间常数 约12秒钟

耗散常数 约2.3W/℃

绝缘电阻 DC500V 100MΩ以上

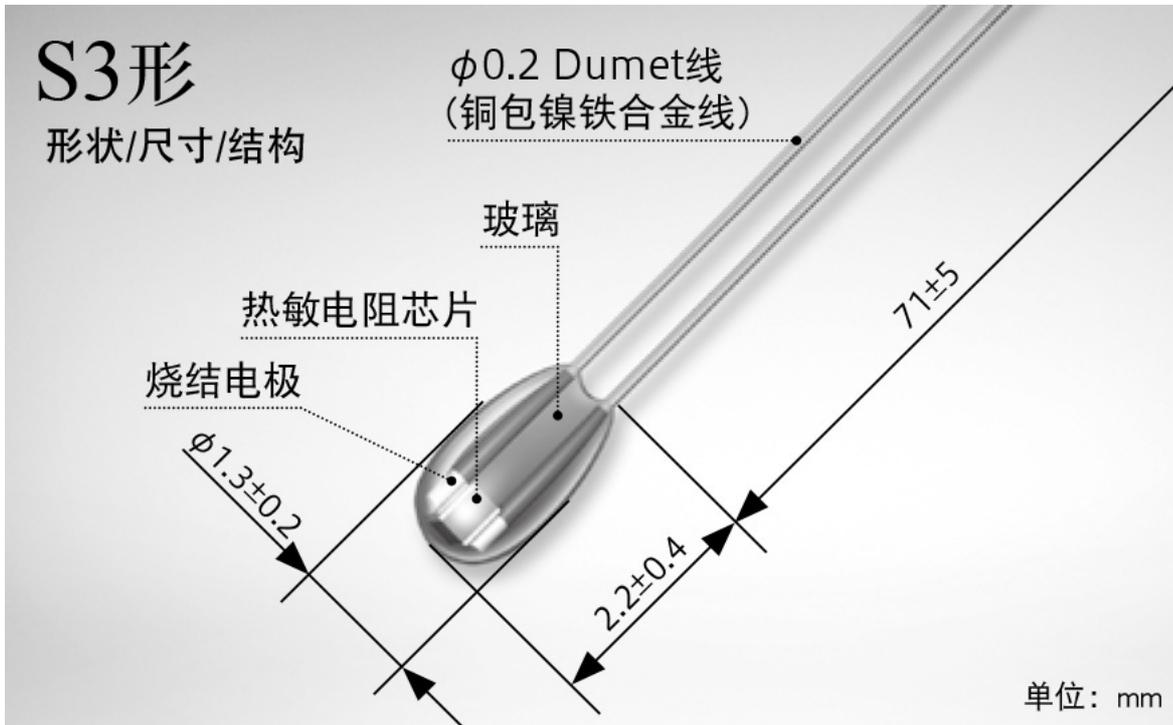
※没有特别记载时，热时间常数及耗散常数是静止空气中的检测结果。

## 规格尺寸



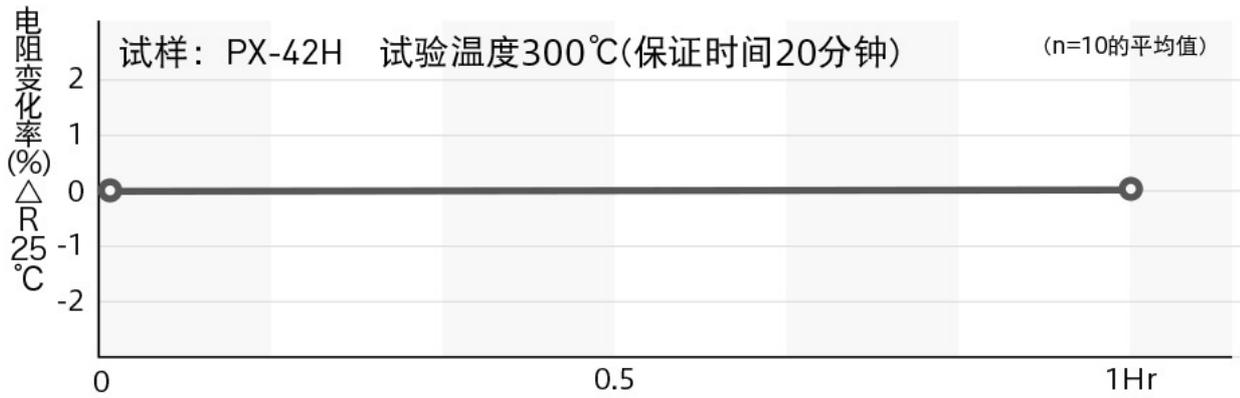
# S3形

形状/尺寸/结构



## 技术参数

耐热试验 (可以高温焊接及高温树脂封装)



耐热试验 (最高工作温度120°C)

